

高分辨率 微米或纳米级三维计算机断层扫描 & 数字化 X 光透视系统

EasyTom



高分辨率三维计算机断层扫描

实时高分辨率数字化 X 光透视

纳米级分辨率配置可选

5-250 μm 分辨率 (0.35 μm 配置可选)

最大样品尺寸(直径 x 高度 : 320 mm x 420 mm)

可编程自动控制重复扫描

样品位置记忆

广泛的应用领域及产品分析

铅及钢铁结构, X 射线内锁定系统, 操作安全

技术规格

- 设备尺寸**
- 2100x1100x2000 mm / 82.6x43.3x78.7 英寸
 - 铅/钢铁结构, X 射线安全互锁, 符合 X 射线安全使用要求
 - X 射线照射时舱门自动锁定
 - 扫描体积(直径 x 高度): 320 mm x 420 mm

- 机械轴**
- 高精度电动选装及移动轴
 - 成像器水平, 竖直方向移动(可选), 增大扫描区域, 降低环形伪影
 - 空气轴承旋转台(可选), 提高载重量

- X 射线管**
- 多种类型射线管可选:
- 封闭式/开放式微米级 X 射线管
 - 开放式纳米级 X 射线管 (160KV)
 - 最高电压至 230 kV (可选)
 - 分辨率 5-250 μm (最高配置可至 0.35 μm)
 - 多种射线管灯丝可选

- 成像器**
- 多种成像器可选:
- 高分辨率平板探测器
 - 大面积平板探测器
 - CCD 探测器

- 计算机**
- 多种强大的 GPU 配置
 - 高分辨率显示器, Windows 10.

- 软件**
- RX Solutions X-Act 软件:
- 主要插件用于驱动 X 光, 成像器, 机械轴, 尺寸测量, 图像/视频导出, 图像采集, 图像过滤, X 光透视, 扫描模式(常规扫描, 分段扫描, 分块扫描, 螺旋扫描)...
 - 宏命令模式用于自动采集数据
 - GPU 加速图像重建
 - 三维可视化及后处理, CAD 比对, 气孔及壁厚分析组件缺陷分析(可选)

